

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2017年5月1日を以ってルネサス セミコンダクタ パッケージ&テスト ソリューションズ株式会社の半導体製造装置をはじめとする各種産業用制御ボードの受託開発・製造および画像認識システム開発・製造・販売事業を日立マクセル株式会社へ譲渡したことにより、当該事業は日立マクセル株式会社の子会社として新設されるマクセルシステムテック株式会社に承継されております。

従いまして、ドキュメント等資料中には、旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

2017年5月1日

マクセルシステムテック株式会社

【発行】 マクセルシステムテック (<http://www.systemtech.maxell.co.jp/>)

【お問い合わせ先】 denki-support@maxell.co.jp

maxell
マクセルシステムテック株式会社

SMALIGHT TECHNICAL UPDATE

〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル8階
株式会社 ルネサス北日本セミコンダクタ
営業本部 電子機器営業部

問合せ窓口: soft.support@kitasemi.renesas.com

製品分類	Smalight OS	発行番号	SL-1001-002	Rev	第1版
題名	割込みマスク操作の注意事項		情報分類	使用上の注意事項	
適用製品	Smalight OS Smalight SDK Smalight RSK Smalight TCP/IP	対象ロット	関連資料	Smalight OS V3リファレンスマニュアル	
		V3以降			

拝啓、貴社益々御清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別の御高配を賜り、感謝申し上げます。

Smalight OS V3以降で以下の注意事項がございます。

【発生条件】

タスク内で割込みマスクレベルを1以上、カーネルマスクレベル未満に設定し、disp有割込みを受け付けたとき。

【現象】

通常、タスクは割込みマスクレベル0で実行しますが、割込みマスクレベル0以外に変更したタスクが実行中のとき、disp有割込みを受け付けると、disp有割込みでは多重割込みと認識します。多重割込みではディスパッチャを実行せずに割込み発生元へ戻ります。

そのとき、disp有割込みハンドラでのOSサービスコール発行によりタスク状態に変更が生じた場合、期待するタスクスケジューリングと異なる動作となる場合があります。

例) disp有割込みハンドラで、iwup_tskサービスコールを発行し一番タスク優先度の高いタスクが、Ready状態になったが、多重割込みとの判断からディスパッチャを実行せず割込み発生元(カレントタスク)に戻ります。それにより優先度の低いカレントタスクがそのままRunning状態となります。

【回避策】

タスクにて、割込みマスクレベル操作で一時的に割込みを抑止したい場合は、必ず、カーネルマスクレベル以上の割込みマスクレベルを設定してください。

— 以上 —